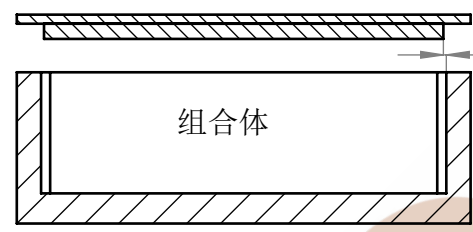
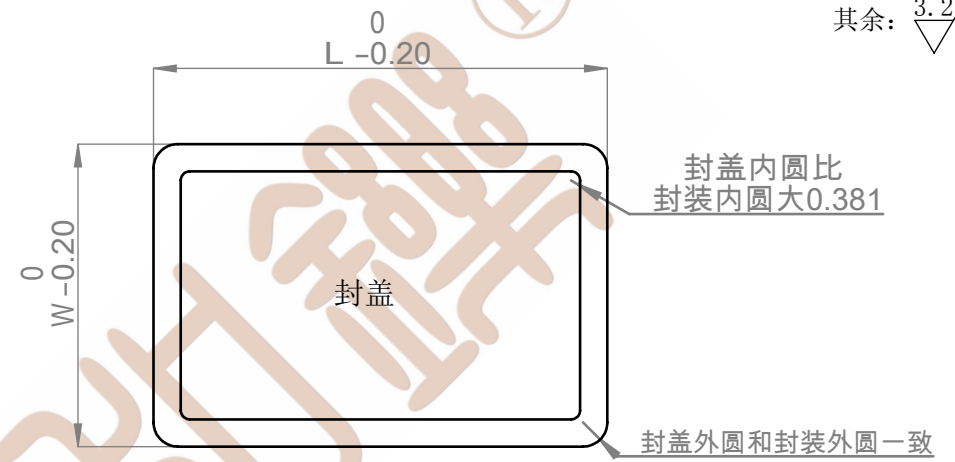
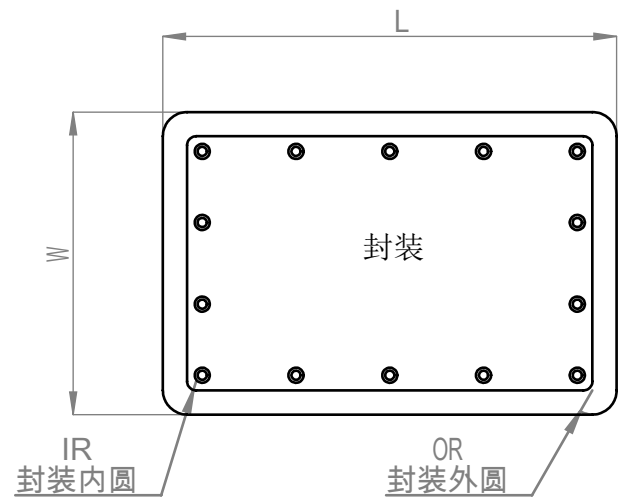
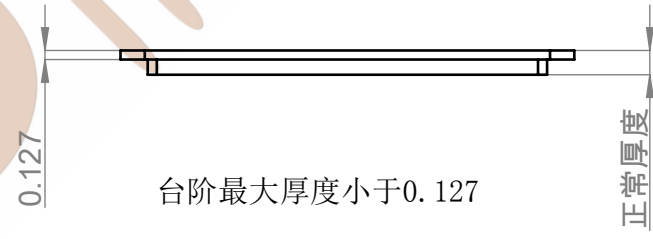




其余:  $\frac{3.2}{\nabla}$



0.10 封盖跟封装基座每边至少留0.1



1. 封盖外尺寸比封装小0.2 (每边0.1)
2. 封盖内尺寸比封装小0.2 (每边0.1)
3. 封盖台阶电镀后厚度不超过0.127
4. 典型材料: 5代
5. 典型电镀层 A: 镍化学镀 1.27-3.81um  
B: 金 1.27um
6. 封盖尺寸不能大于封装基座尺寸

内部单号		材料		深圳市和铄金属有限公司	
订单号		数量		零件名称:	
打标				图纸图号:	
交期		单位	mm	比例	1:1
设计时间	2019/9/4	视角	第一视角		
				物料编码:	